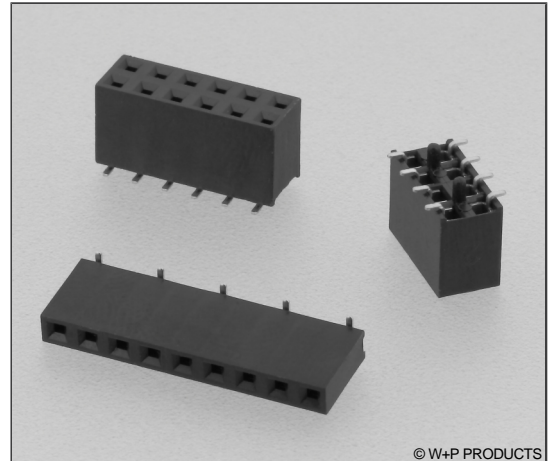


SMT-Buchsenleisten RM 2,54mm, stehend, 1-/2-reihig – BH 7,5mm SMT Female Headers, 2.54mm Pitch, Vertical, Single/Double Row – 7.5mm Profile

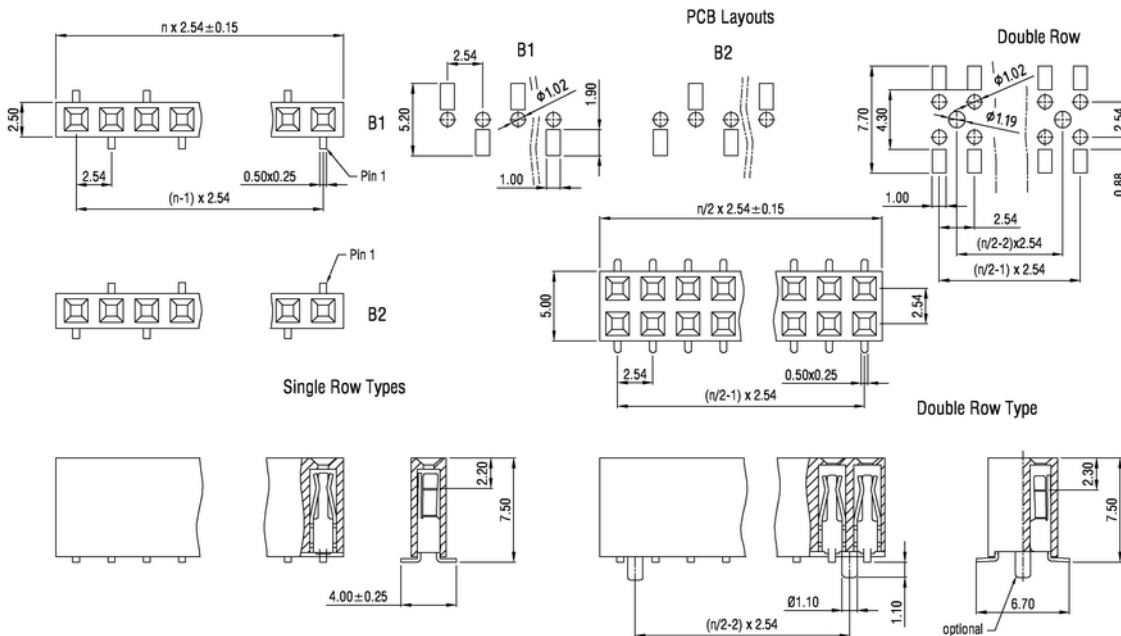
Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Kontakt für Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>Contact for square pin 0.635mm, copper alloy</i> |
| Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i> | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 500V _{AC} |
| Nennspannung <i>Voltage Rating</i> | 250V _{AC} |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 3A |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -40°C ... +125°C |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i> |



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,635mm.
Dual beam contacts accept 0.635mm square pins.



| | | | | | |
|---------------|---|---|--|---|--------------------|
| Series | Contacts* | Rows* | Plating* | Locating Pegs* | Packaging* |
| 3490 | 16 | 1 | 50 | 00 | ST |
| | 04-40 Einreihig <i>Single row</i> 04-20 Zweireihig <i>Double row</i> | 1 Einreihig B1 <i>Single row B1</i> 2 Einreihig B2 <i>Single row B2</i> 3 Zweireihig <i>Double row</i> | 00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i> | 00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen (nur zweireihig) <i>With loc. pegs (double row only)</i> | ST PPST PPTR |

Für zweireihige Polzahlen > 20 s. **3494**
For double row contacts > 20 s. **3494**

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
PPST In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150°C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200°C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217°C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260°C ±5 |
| Dauer Höchsttemperatur | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P | Max. 8 min |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150°C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200°C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217°C |
| Duration above T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Peak Temperature T_P | 260°C ±5 |
| Duration Peak Temperature | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | Max. 8min |

